

Title (en)

METHOD FOR PRODUCING A CHIPBOARD AND CHIPBOARD

Title (de)

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SPANPLATTE SOWIE SPANPLATTE

Title (fr)

PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN PANNEAU DE PARTICULES AINSI QUE PANNEAU DE PARTICULES

Publication

**EP 4364918 A1 20240508 (DE)**

Application

**EP 22205767 A 20221107**

Priority

EP 22205767 A 20221107

Abstract (en)

[origin: WO2024099870A1] The invention relates to a method for coating a water-resistant particle board (1) in order to improve the usability of the particle board and make it more versatile, wherein the particle board comprises wood chips having a length of 0.5-50 mm, a width of 0.1-20 mm and a thickness of 0.05-2 mm, and comprises at least one adhesive having an adhesive content of at least 12 wt.% dry matter content wood, the method comprising the following steps: - providing the particle board (1) having an upper face (1a), a lower face (1b) and side faces, - applying a coating (3), - applying a decoration, - optionally structuring the coating (3) at least on a portion of the upper face, on a portion of the lower face, and on a portion of one side face, and - optionally curing the coating. The invention also relates to a coated, water-resistant particle board.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten einer wasserfesten Spanplatte (1), um die Spanplatte besser und vielseitiger einsetzbar zu machen, wobei die Spanplatte Späne aus Holz und wenigstens einen Klebstoff mit einem Klebstoffanteil von mindestens 12 Gew.-% /atro Holz aufweist, mit den Schritten:- Bereitstellen der Spanplatte (1), die eine Oberseite (1a) und eine Unterseite (1b) und Seitenflächen aufweist,- Auftragen einer Beschichtung,- Aufbringen eines Dekors (2),- ggf. Strukturieren der Beschichtung, jeweils auf mindestens einem Abschnitt einer Oberseite (1a), einer Unterseite (1b) oder einer Seitenfläche, sowie- ggf. Aushärten der Beschichtung. Die Erfindung betrifft weiter eine beschichtete, wasserfeste Spanplatte (1).

IPC 8 full level

**B27N 1/00** (2006.01); **B27N 3/02** (2006.01); **B27N 3/18** (2006.01); **B27N 7/00** (2006.01); **E04C 2/16** (2006.01); **B27N 3/20** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B27N 1/006** (2013.01); **B27N 3/02** (2013.01); **B27N 3/18** (2013.01); **B27N 7/00** (2013.01); **B27N 7/005** (2013.01); **B27N 3/203** (2013.01); **E04C 2/16** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] EP 3736095 A2 20201111 - SWISS KRONO TEC AG [CH]
- [X] EP 3725481 A1 20201021 - SWISS KRONO TEC AG [CH]

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA

Designated validation state (EPC)

KH MA MD TN

DOCDB simple family (publication)

**EP 4364918 A1 20240508**; WO 2024099870 A1 20240516

DOCDB simple family (application)

**EP 22205767 A 20221107**; EP 2023080554 W 20231102